(上接 D13 版)

上述固定资产折旧对公司 2022 年合并利润总额的影响金额为 146.34 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

公司首发募投项目建设实施地位于惠州。2022 年公司募投项目投产后,相关研发、生产等部门陆续搬迁至惠州。搬迁过程中,公司对于同意随公司搬迁至惠州的员工给予相应的随迁补偿奖励,对于无法随迁的员工给予相应的辞退补偿金。经统计,公司发生的随迁奖励及辞退补偿金产生的费用具体如下:

项目	随迁奖励(万元)	辞退补偿(万元)
销售费用	460.25	12.68
管理费用	243.55	444.90
研发费用	233.62	7.84
存货/营业成本	89.67	2.00
合计	1,027.09	467.42

上述随迁奖励费和辞退补偿金对公司 2022 年合并利润总额的影响金额为 1,494.51 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

(二)补充披露"深科达智能制造创新示范基地续建工程"两个子项目的最新进展,是否存在延期风险,是否符合募集资金使用计划和募集资金使用制度的相关规定

1、可转换公司债券募投项目的最新进展

根据《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中募集资金使用计划,本次可转债募集资金主要用于"深科达智能制造创新示范基地续建工程"、"深科达智能制造创新示范基地"以及"补充流动资金","深科达智能制造创新示范基地续建工程"包含 2 个子项目"惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目"、"半导体先进封装测试设备研发及生产项目"。

子项目"惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目"拟通过建设生产与办公场地,购置先进生产设备及产线,用于新型平板显示智能装备生产,以扩大公司生产能力和产能规模,本项目旨在向 Mini/Micro-LED 等新型高端显示设备进军,在现有平板显示设备产品基础上,先后对 Mini-LED 和 Micro-LED 精密组装检测设备进行研发生产,增加公司产品线,同时扩大公司的产品生产规模,提高产品供应能力,促进公司新产品的产业化生产,丰富公司产品种类,在优化产品结构的同时也增强公司规模效应。本项目建设期规划为 2 年,项目进度计划内容包括工程设计及准备工作、土建施工、设备购买及安装调试、新员工招聘培训、试生产及验收等。

子项目"半导体先进封装测试设备研发及生产项目"拟通过建设生产与办公场地、购置先进的研发及生产设备,以满足公司半导体先进封装测试设备研发及生产所需,本项目是在公司现有半导体封测测试设备的基础上,针对先进封装的工艺特点,研发新的产品线,拓展公司业务类别,扩大公司产能规模。本项目建设期为 2 年,项目进度计划内容包括工程设计及准备工作、场地建设及装修、设备购买及安装调试、新员工招聘培训、试生产及验收等。

2022 年度,对于募投项目建设,公司重点在于推进首发募投项目"深科达智能制造创新示范基地"一期工程按期竣工。2022 年 11 月首发募投项目结项投入使用后,产能尚未完全释放,可以满足现阶段研发生产的使用所需,公司根据现阶段的产能情况,依托现有生产基地,继续开展募投项目"深科达智能制造创新示范基地续建工程"2 个子项目计划研发生产的 Mini/Micro-LED 显示设备以及半导体先进封装测试设备的研发工作,并取得了一定的成果。Mini/Micro-LED 显示设备相关的研发项目"挑晶机"目前已进入小批量量产阶段;半导体先进封装测试设备相关的研发项目"CP 探针台研发项目"已经入样机验证阶段。

根据《募集说明书》中项目的规划进度,"深科达智能制造创新示范基地续建工程"2 个子项目建设期为 2 年,目前公司尚未开始正式建设,公司管理层将根据公司经营情况积极推进可转债募投项目建设,可转债募投项目不存在延期风险。

2、可转债募投项目符合募集资金使用计划和募集资金使用制度的相关规定

根据《募集说明书》募集资金使用计划,"公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。"

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等规定,已对募集资金进行专户管理,并与保荐机构以及存放募集资金的银行签订了《三方监管协议》,公司按规定编制《募集存放与使用专项报告》并定期披露;严格按照相关规定使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

公司本次募集的使用符合公司实际情况和《募集说明书》中募集资金使用计划和募集资金使用制度,公司将密切关注募投项目建设情况,按照相关制度规定,及时履行信息披露义务。

二、年审会计师核查程序及核查意见

(一)核查程序:

年审会计师履行了如下核查程序:

1、查阅公司固定资产折旧计提政策,并检查公司固定资产折旧明细表,了解首发募投项目投产后,相关折旧费用对公司业绩的影响。

2、查阅公司搬迁离职补偿和随迁奖励的方案,检查搬迁离职补偿与随迁奖励金额计算是否正确,检查相关会计处理是否符合企业会计准则规定,了解搬迁离职补偿和随迁奖励费用对公司业绩的影响。

3、访谈公司管理层,了解"深科达智能制造创新示范基地续建工程"两个子项目的最新进展以及后续建设安排。

4、查阅募集说明书与公司募集资金使用制度,获取公司募集资金使用明细,检查募集资金投入是否符合募集资金使用计划和募集资金使用制度的规定。

(二)核查结论

经核查,年审会计师认为:

1、公司首发募投项目投产后,新增固定资产折旧费用合计减少公司合并利润总额 146.34 万元,搬迁离职补偿和随迁奖励合计减少公司合并利润总额 1,494.51 万元,公司已按照企业会计准则相关规定进行了会计处理,并说明了相关费用对于公司业绩的影响;

2、公司"深科达智能制造创新示范基地续建工程"两个子项目尚未开始建设,原因主要是公司首发募投项目投产后产能尚未完全释放,现有场地可以满足现阶段生产所需。公司根据现阶段的产能情况,依托现有生产基地,正开展"深科达智能制造创新示范基地续建工程"2 个子项目计划研发生产的 Mini/Micro-LED 显示设备以及半导体先进封装测试设备的研发工作,但相关项目建设尚未开展。根据"深科达智能制造创新示范基地续建工程"两个子项目的研发、投资与量产计划,可转债募投项目尚未延期。公司已根据规定制定《募集资金管理制度》,并已同保荐机构及存放募集资金的银行签订了《三方监管协议》,对募集资金进行专户管理,也按规定对募集资金相关的事项及时进行了披露,公司募集资金投入符合募集资金使用制度的规定。

三、持续督导机构核查程序及核查意见

(一)核查程序

持续督导机构执行了下列核查程序:

1、查阅公司固定资产折旧计提政策,并检查公司固定资产折旧明细表,了解首发募投项目投产后,相关折旧费用对公司业绩的影响;

2、查阅公司搬迁离职补偿和随迁奖励的方案,检查搬迁离职补偿与随迁奖励金额计算是否正确,检查相关会计处理是否符合企业会计准则规定,了解搬迁离职补偿和随迁奖励费用对公司业绩的影响;

3、访谈公司管理层,了解"深科达智能制造创新示范基地续建工程"两个子项目的最新进展以及后续建设安排;

4、查阅募集说明书与公司募集资金使用制度,获取公司募集资金使用明细,检查募集资金投入是否符合募集资金使用计划和募集资金使用制度的规定。

(二)核查结论

经核查,年审会计师认为:

1、公司首发募投项目投产后,新增固定资产折旧费用合计减少公司合并利润总额 146.34 万元,搬迁离职补偿和随迁奖励合计减少公司合并利润总额 1,494.51 万元,公司已按照企业会计准则相关规定进行了会计处理,并说明了相关费用对于公司业绩的影响;

2、"深科达智能制造创新示范基地续建工程"两个子项目尚未开始建设,原因主要是公司首发募投项目投产后产能尚未完全释放,现有场地可以满足现阶段生产所需。公司根据现阶段的产能情况,依托现有生产基地,正开展"深科达智能制造创新示范基地续建工程"2 个子项目计划研发生产的 Mini/Micro-LED 显示设备以及半导体先进封装测试设备的研发工作,但相关项目建设尚未开展。根据"深科达智能制造创新示范基地续建工程"两个子项目的研发、投资与量产计划,可转债募投项目尚未延期,持续督导机构将持续关注相关项目实施进展,如募投项目后续出现延期迹象或其他重大变化,持续督导机构将督促公司及时公告并进行风险提示。公司已根据规定制定《募集资金管理制度》,并已同保荐机构及存放募集资金的银行签订了《三方监管协议》,对募集资金进行专户管理,也按规定对募集资金相关的事项及时进行了披露,公司募集资金投入符合募集资金使用计划和募集资金使用制度的规定。

问题 5:关于半导体、VR 设备等在研项目

年报显示,公司目前在研项目包括平移式、双轨式、重力式测试分选机,VR 镜片贴合设备、探针台、划片机等新产品,公司主营产品包括转塔测试分选机。请公司结合核心技术及先进性、产品用途、主要客户及验证进展、在手订单、细分市场总体规模及行业竞争状况,分产品说明是否存在研发失败或难以获取订单等风险,并预计对公司未来收入、净利润的影响。

一、公司回复

公司相关在研项目情况说明如下:

类别	在研项目	核心技术及先进性	产品用途	主要客户及验证进展	在手订单	市场规模	行业竞争状况	研发失败或获取订单风险	预计对公司未来业绩的影响
半导体设备	平移式分测试分选机	核心技术:XYZ三轴运动平台高速高精度结构及控制技术、晶圆自动对位检测定位技术、探针台Z向距离自动测量对针技术、超精度视觉定位技术、高精度运动控制技术、超小压力控制技术、先进特性;特高温加热测试、镭射打标、2D视觉检测等功能多合一技术	适用于QFN/QFP/LGA/BGA/CSP/SIMCard等封装芯片,进行芯片性能测试,并根据测试结果分类输出	已在半导体封测端客户进行验证	正在积极开拓市场与客户商务洽谈中	据SEMI统计2021年全球半导体设备市场1,026亿美元,2022年为1,076亿美元,半导体测试设备占比8.71%,半导体测试设备在可预见的未来将持续保持增长态势	国外厂商凭借先发技术优势占据绝大部分国内市场份额,国内企业长川科技、金海通、昌红科技、嘉晖、奥特维、矽电、鼎龙、盛美等正在积极开拓市场与客户商务洽谈中	半导体设备研发及取得订单风险较小;目前国内主要设备厂商均在积极客户进行验证,并在客户反馈效好,正向进行商务洽谈,发展取得订单的较大趋势	平移式分选机、双轨式分选机以及重力式测试分选机预计未来三年合计将给公司带来33,000万元营业收入,4,800万元净利润
	双轨式分测试分选机			主要客户包括固锝沃克微(江苏)等	已有少量订单,且正在积极开拓市场与客户商务洽谈中				
	重力式分测试分选机		用于半导体元器件的商试分选及包装	针对TO系列封装功率器件产品高温测试而设计的全自动分选机	重力式测试分选机在客户验证阶段,客户反馈:设备噪音小、UPH高、设备稳定				
					已有少量在手订单,且正在积极开拓市场与客户商务洽谈中				
	CP探针台		主要应用于消费级、工业级、汽车级、军用级等不同类型的芯片测试	已出货至客户苏州英嘉通半导体有限公司等,并已通过客户验证	已有样机出货,与客户商务洽谈中				预计未来三年合计将给公司带来6,400万元营业收入,640万元净利润
	划片机		要应用于半导体晶片、LED芯片&EMC导线架、PCB、QFN、BGA、监宝石玻璃、陶瓷薄板等超高精密切割	功能模块验证中	暂无订单				预计未来三年合计将给公司带来770万元营业收入、90万元净利润
	VR镜片光学硬贴对合	核心技术:高精度网板式贴合和真空贴合技术,压力传感器实时通讯技术,高洁局设计搭载高速高精度直线电机搬运技术,C型过框高精度装技术,高精度形定位技术,缺陷叠加分析技术等;技术先进性:具有大压力、高精度等优势,处于国内行业领先水平	VR贴合设备已在客户歌尔股份进行验证	已有样机出货,正在积极开拓客户商务洽谈中	据DSCC测算,Mini/Micro-LED在电视上渗透率长,其市场规模有望从2020年的2500万美元上涨到2026年的2.28亿美元;VR贴合相关设备2020年市场总规模630万台,年平均增速50%以上,其中Pancake镜片模组占比将会越来越高	美国、德国、韩国等厂商的设备占新一代显示面板制程装备市场统治性地位,国内厂家挑战与机会并存,前景广阔	研发技术已达过测试客户要求,研发失败风险较小;正在积极争取客户订单,获单风险较小	预计未来三年合计将给公司带来1,550万元营业收入、190万元净利润
	超声波指纹贴合		适用于VR显示光学镜头模组Pancake中多结构的镜片点胶组装,液晶模组和指纹模组的贴合组装,Mini-LED/AR/VR的显示基板前段阶段的检测(应用场景多为手机、平板、车载、电视等显示面板的背光)	超声波指纹贴合设备已与客户GIS、OFG、丘钛、京东方等进行合作	已有设备出货,正在积极开拓市场与客户商务洽谈中				预计未来三年合计将给公司带来3,000万元营业收入、300万元净利润
	挑晶机			挑晶机已通过三安光电等试用验证并在商务洽谈中	少量在手订单,正在积极开拓客户商务洽谈中				预计未来三年合计将给公司带来5,600万元营业收入、570万元净利润
	2DBLU显示器研发			已与客户GIS进行合作	已有设备出货,正在积极开拓市场与客户商务洽谈中				预计未来三年合计将给公司带来10,500万元营业收入、950万元净利润
核心零部件	伺服驱动器	核心技术:高速高精智能自动化设备,3C电子设备,面板显示设备,锂电设备,数控加工中心,平板打印机,金属加工设备,具有性能强,成本低等特点	主要应用在各种自动化设备上,如半导体设备、3C电子设备、面板显示设备、锂电设备、数控加工中心、平板打印机、金属加工设备,具有性能强,成本低等特点	已搭载于公司现有设备产品上进行销售	2022年中国运动控制器市场规模约为85亿元;在国家政策的大力支持下,高档数控具有广阔的发展空间,预计2025年中国运动控制器市场规模有望突破100亿元。磁栅尺以及光栅尺需求随着物流、制造等产业自动化程度提升,预计2025年市场规模将达到15.6亿元	国外厂商西门子、德国倍福自动化有限公司、海德汉等占据国内高端市场,本土企业有望凭数控科技股份有限公司、深圳市雷赛智能控制股份有限公司等,多集中在中低端市场	已搭载公司设备产品上使用,不存在失败风险	预计核心零部件未来三年合计将给公司带来3,100万元营业收入、310万元净利润;振动盘搭配于半导体分选设备进行销售,不单独计算收入
	磁栅读数头								
	运动控制器								
	振动盘								
软件类研发	半导体AOI芯片检测系统	高速高精智能化直线电机驱动技术、光学成像技术、深度学习技术、计算机并行处理技术、精密视觉对位技术、高精度相机标定技术、多目标图像识别分析技术、对位机精度补偿技术等;技术先进性:能够检测并识别检测目标物体的微小缺陷和异常,精度高,处于国内行业领先水平	适用于半导体功率器件、集成电路IC芯片制造的封测、晶圆划片后检测、晶粒装片及焊线后检测	样品已在客户端声声学科技及上海川土微电子进行验证,并初步满足客户需求	正在积极开拓与客户商务洽谈中	根据Grand View Research市场调研机构的数据,预计到2027年全球AOI检测行业的整体市场规模在194亿美元左右,据CINNO?ePaperInsight统计2022年电子纸终端市场规模增速达45%;技术之首,由此可见搭载于电子纸终端的AOI检测设备市场规模有望成为千亿级别市场	目前国内AOI检测行业基本形成国际知名品牌、国内上市公司及知名品牌、其余中小AOI检测设备制造公司的三个梯次。其中高端品牌主要由国际知名品牌占据,包括日本、奥宝科技、奥姆龙、由田新技等;中低端市场包括国内上市公司及知名品牌,而众多中小企业则集聚于AOI检测设备的低端领域	样品已送客户端声声学科技及上海川土微电子进行验证,并初步满足客户需求,且客户端声声学科技及上海川土微电子进行商务洽谈,研发及取得订单风险较小	预计未来三年合计将给公司带来1550万元营业收入、150万元净利润
	电子纸缺陷检测系统		适用于电子纸显示与外观、电子纸前段点胶检测、FPC外观检测等	样品已在客户联积电子、川崎电子及东方科迈电子进行验证,初步满足客户需求	正在积极开拓与客户商务洽谈中				

二、年审会计师核查程序及核查意见

(一)核查程序

年审会计师履行了如下核查程序:

1、访谈公司管理层,了解公司在研项目的进展情况,市场前景、行业竞争情况、主要客户及验证进展情况。

2、查询行业研究报告,了解公司在研项目涉及产品的市场情况及行业竞争情况。

(二)核查结论

经核查,年审会计师认为:

公司已分产品说明在研项目的核心技术与先进性、产品用途、主要客户及验证进展、在手订单、市场规模及竞争状况等情况;现有在研项目以公司掌握的核心技术为依托,以多年来的智能装备研发制造经验为支撑,具有技术可行性,目前研发进展未出现重大异常,研发失败的风险较小;公司正积极拓展在研项目对应产品的市场订单,目前市场开拓活动进展顺利,难以获取订单的风险较小。

三、持续督导机构核查程序及核查意见

(一)核查程序

持续督导机构执行了下列核查程序:

1、访谈公司管理层,了解公司在研项目的进展情况,市场前景、行业竞争情况、主要客户及验证进展情况;

2、查询行业研究报告,了解公司在研项目涉及产品的市场情况及行业竞争情况。

(二)核查结论

经核查,持续督导机构认为:

公司已分产品说明在研项目的核心技术与先进性、产品用途、主要客户及验证进展、在手订单、市场规模及竞争状况等情况;现有在研项目以公司掌握的核心技术为依托,以多年来的智能装备研发制造经验为支撑,具有技术可行性,目前研发进展未出现重大异常,研发失败的风险较小;公司正积极拓展在研项目对应产品的市场订单,目前市场开拓活动进展顺利,难以获取订单的风险较小。

问题 6:关于子公司股权激励

年报显示,公司在子公司层面(线马科技、深科达半导体)进行股权激励。请公司:(1)补充说明子公司层面进行股权激励的必要性及合理性;(2)补充披露股份支付费用计算过程、相应的会计处理及对公司经营业绩的影响;(3)补充说明上述股权激励是否设置考核指标,及业绩指标完成情况。

一、公司回复

(一)补充说明子公司层面进行股权激励的必要性及合理性

公司在子公司层面进行股权激励是基于公司实际经营情况作出的选择,一方面,线马科技及深科达半导体是公司 2016 年开始布局的主营业务经营主体,经过近几年的发展,深科达半导体及线马科技相关业务已经形成了一定规模,且对公司业绩贡献较大,但两家公司的核心管理团队成员并未持有公司股份,且仅个别核心人员持有子公司股权,因此,为进一步提高子公司核心经营团队积极性,将子公司核心经营团队利益与子公司经营业绩紧密挂钩,完善各子公司的长期激励机制和人才战略,推动子公司可持续发展,公司选择在子公司层面进行股权激励;另一方面,2021 年公司上市时,子公司核心管理团队对股权激励的期望较高,但由于当时上市公司层面尚未确认股权激励整体实施方案,因此,为了吸引人才和稳定子公司核心管理团队,公司选择在子公司层面进行股权激励。

综上所述,公司在子公司层面实施股权激励具有必要性和合理性。

(二)补充披露股份支付费用计算过程、相应的会计处理及对公司经营业绩的影响

1、股份支付以及利润分享计划计算过程

(1)线马科技:2021 年 11 月对核心员工晁元臻等进行股权激励

授予时间	授予股份数量(万股)(A)	授予价格(元/股)(B)	授予日股份公允价格(元/股)(C)	公允价格确定依据	股支总额(元)(D=A*(C-B))	等待期	股份支付分年度确认金额(万元)		退出限制
							2021 年(E=D/36)	2022 年(E=D*12/36)	
2021 年 11 月	49.02	9.18	45.72	深圳中洲资产评估有限公司出具评估报告的评估价格	1,791.16	自授予之日起,服务期限不少于 3 年	49.75	597.05	退出限制:服务期满,被激励员工可以以市场价格转让给公司指定的人员,服务期未满,被激励员工按照原价转让给公司指定的员工

(2)深科达半导体:a.对深科达半导体王建勇等核心员工进行激励,实际控制人黄奕宏低价转让所持有的深科达半导体股份给深科达半导体公司核心员工

授予时间	授予股份数量(万股)(A)	授予价格(元/股)(B)	授予日股份公允价格(元/股)(C)	公允价格确定依据	股支总额(元)(D=A*(C-B))	等待期	利润分享分年度确认金额(万元)		退出限制
							2021 年(E=A*C)	2022 年(F=A*D)	
2021 年 8 月	12.50	8.04	5.48	5.02	根据科达半导体每年末股资确定	自授予之日起,服务期限不少于 3 年	68.49	62.68	退出限制:服务期满,被激励员工可以以深科达半导体最近一个月每股净资产价格转让给深科达半导体其他股东或其他指定人员,服务期未满,被激励员工以受让时的出资额转让给深科达半导体其他股东或其他指定人员

(2)深科达半导体:b.对深科达半导体陈林山等核心员工进行激励,股东苗勇低价转让所持有的深科达半导体股份给深科达半导体公司核心员工

授予时间	授予股份数量(万股)(A)	授予价格(元/股)(B)	授予日股份公允价格(元/股)(C)	公允价格确定依据	股支总额(元)(D=A*(C-B))	等待期	利润分享分年度确认金额(万元)		退出限制
							2021 年(E=A*C)	2022 年(F=A*D)	
2021 年 6 月	20.51	5.84	7.68	5.02	根据科达半导体每年末股资确定	自授予之日起,服务期限不少于 3 年	157.46	102.89	退出限制:服务期满,被激励员工可以以深科达半导体最近一个月每股净资产价格转让给深科达半导体其他股东或其他指定人员,服务期未满,被激励员工以受让时的出资额转让给深科达半导体其他股东或其他指定人员

2、相应的会计处理及对公司经营业绩的影响

以上股权激励,公司根据受激励员工所在部门,分年度确认股份支付金额计入相关成本费用,同时增加资本公积。2022 年度,公司子公司线马科技确认股份支付成本费用金额 597.05 万元,增加资本公积 597.05 万元。公司子公司深科达半导体确认利润分享计划成本费用金额 165.57 万元,增加资本公积 165.57 万元。2022 年因确认股份支付及利润分享计划,减少公司合并利润总额 762.62 万元,同时,公司将分期确认的股份支付及利润分享计划金额作为当期经常性损益列报,不影响公司的扣除非经常性损益净利润。

(三)补充说明上述股权激励是否设置考核指标,及业绩指标完成情况

为保障线马科技增资暨股权激励对线马科技发展的激励效果,线马科技对核心员工股权激励设立了以下业绩考核及股权回购条件:

1、以线马科技 2021 年经审计的营业收入为业绩基数,考核 2022-2024 年每年营业收入对比 2021 年营业收入的增长率,三年累计的营业收入增长率(如某年增长率为负值,需累计相加计算)不低于 120.00%。

2、如未达到三年累计营业收入增长率指标,则线马科技需要在 2025 年按照本次增资的股权对价加上不超过同期银行贷款利率的利息将本次增资股权全部进行回购。

根据上述设定的业绩指标,以线马科技 2021 年营业收入为基础,考核的是未来三年累计营业收入增长率,换算出未来三年每年需实现营业收入增长比例为 40%。线马科技 2021 实现营业收入 8,654.02 万元,2022 年实现营业收入 12,469.11 万元,线马科技 2022 年实现的营业收入较 2021 年增长 44.08%,故线马科技 2022 年实现的业绩增长率已达到线马科技股权激励第一年业绩目标。

深科达半导体未明确设定股权激励业绩目标,主要原因为:深科达半导体核心员工与深科达半导体签署的服务期协议中约定了服务期限,被激励员工可以以深科达半导体最近一个月每股净资产价格转让给深科达半导体其他股东或其他指定人员。相比而言,深科达半导体核心员工当时出资受让深科达半导体股权激励时即按照最近一年一期净资产作价,服务期满退出时仍按照深科达半导体最近一期净资产退出,其能获得的收益仅为净资产增值对应部分的金额。因此,只有深科达半导体核心员工不断创造提高深科达半导体业绩,才能带来深科达半导体净资产的增加,最终服务期届满时才能获益较高。

二、年审会计师核查程序及核查意见

(一)核查程序

年审会计师履行了如下核查程序:

1、访谈公司管理层,了解在子公司层面进行股权激励的原因,分析其必要性及合理性。

2、获取公司股份支付和利润分享计划相关费用计算表,复核公司股份支付和利润分享计划相关费用计算结果,检查公司相关会计处理是否与企业会计准则的规定相符。

3、查阅子公司财务报表及相关股权激励协议,了解公司股权激励业绩考核指标设置情况以及业绩指标完成情况。

(二)核查结论

经核查,年审会计师认为:

1、公司在子公司层面进行股权激励是基于其实际经营情况作出的选择,目的在于调动子公司核心管理团队积极性,进一步推动公司及子公司业务发展,具有必要性及合理性。

2、公司 2022 年度股份支付及利润分享计划相关费用计算正确,会计处理符合企业会计准则规定,股份支付及利润分享计划会计减少公司合并利润总额 762.62 万元。

3、公司对于线马科技层面的股权激励设置了相应考核指标,2022 年相关业绩考核指标已完成;对于深科达半导体层面的股权激励,公司未设置考核指标,原因在于根据协议约定深科达半导体相关激励对象服务期满后退出时获得收益为深科达半导体净资产增值部分对应的份额,该约定相当于隐形考核目标,因此深科达半导体相关股权激励未设置考核目标具有合理性。

三、持续督导机构核查程序及核查意见

(一)核查程序

持续督导机构执行了下列核查程序:

1、访谈公司管理层,了解在子公司层面进行股权激励的原因,分析其必要性及合理性;

2、获取公司股份支付和利润分享计划相关费用计算表,复核公司股份支付和利润分享计划相关费用计算结果,检查公司相关会计处理是否与企业会计准则的规定相符;

3、查阅子公司财务报表及相关股权激励协议,了解公司股权激励业绩考核指标设置情况以及业绩指标完成情况。

(二)核查结论

经核查,持续督导机构认为:

1、公司在子公司层面进行股权激励是基于其实际经营情况作出的选择,目的在于调动子公司核心管理团队积极性,进一步推动公司及子公司业务发展,具有必要性及合理性。

2、公司 2022 年度股份支付及利润分享计划相关费用计算正确,会计处理符合企业会计准则规定,股份支付及利润分享计划会计减少公司合并利润总额 762.62 万元。

3、公司对于线马科技层面的股权激励设置了相应考核指标,2022 年相关业绩考核指标已完成;对于深科达半导体层面的股权激励,公司未设置考核指标,原因在于根据协议约定深科达半导体相关激励对象服务期满后退出时获得收益为深科达半导体净资产增值部分对应的份额,该约定相当于隐形考核目标,因此深科达半导体相关股权激励未设置考核目标具有合理性。

问题 7:关于子公司管理

公司主要经营实体为控股子公司,且进行股权激励。请公司:(1)说明公司对子公司的管理方式,结合重大经营决策安排、人员派驻、资金客户技术等关键资源管控等,说明是否能实现有效控制;(2)结合公司对子公司管理相关内部控制的规定,说明是否能及时排查并解决可能导致子公司失控的风险事项。

一、公司回复

(一)说明公司对子公司的管理方式,结合重大经营决策安排、人员派驻、资金客户技术等关键资源管控等,说明是否能实现有效控制

截至目前,公司主要控股子公司如下:

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳线马科技有限公司	54.40	54.40
深圳市深科达半导体科技有限公司	60.00	60.00
深圳市深科达微电子设备有限公司	60.00	60.00
深圳市深能致科技有限公司	60.00	60.00
深圳市深卓达科技有限公司	65.00	65.00
深圳市明测科技有限公司	60.00	60.00
深圳旭丰智能装备有限公司	51.00	51.00
深圳市矽谷半导体设备有限公司	60.00	60.00

公司对子公司经营管理决策、财务内控等方面采取了有效措施,发挥公司管理优势,规范子公司各项内部控制管理,具体管控行制度及实施情况如下:

1、经营管理决策方面:公司持有子公司半数以上表决权,在子公司整体发展战略、日常经营等重大经营管理决策方面具有决定性影响;子公司按照公司《全面预算管理制度》实行全面预算管理,编制年度预算并呈报公司,公司每月召集子公司参加经营管理会议,统一向公司汇报当月营业状况、财务状况、日常管理状况等事项。

2、人员派驻方面:公司董事长、总经理黄奕宏先生同时担任子公司线马科技董事长、深科达半导体董事长、深科达微电子董事长;公司董事、副总经理、财务负责人张新明先生同时担任子公司线马科技董事、深科达半导体董事、深科达微电子董事,黄奕宏先生和张新明先生可通过子公司董事会、股东会等方式直接参与子公司重大经营决策及活动。

3、财务方面:公司遵循"垂直管理,分级控制"的原则,公司财务负责人直接领导公司财务中心,公司财务中心统一管理公司会计部及资金部。公司积极构建集团式财务信息系统,子公司会计部日常账务核算需经公司财务中心副总监审核,子公司财务报表及报表分析需上报公司财务中心副总监及财务负责人。公司资金部直接管理全部子公司的资金相关事项,子公司出纳由公司资金部人员担任,资金部负责子公司日常经营付款申请的审核授权、银行授信的办理、票据管理、组织月度现金盘点的事项。公司为子公司向银行的等金融机构的综合授信申请提供担保,并在不影响公司日常经营的情况下为子公司提供借款,支持子公司发展壮大。

4、客户资源管控:公司统一对客户进行建档管理,公司设立半导体销售分公司和自动化销售分公司,利用公司已有客户资源优势和品牌知名度,拓宽子公司销售渠道,挖掘潜在客户。

5、技术资源管控:公司设立知识产权部,组建知识产权团队,打造知识产权管理平台,统一管理公司及子公司知识产权的创造、运用、保护和管理工作。知识产权部在公司及子公司范围内完善知识产权保密控制程序,监控追踪最新专利信息,开展合同知识产权条款审核、侵权分析,组织知识产权培训以提高相关人员的知识产权意识和专业能力。

此外,公司法务部负责公司合规建设管控,审核公司及子公司销售合同、招标文件、采购合同、用印文件等。子公司公章、财务章、法人私章、营业执照等重要物品资料统一存放于公司集中管理,按相关规定申请审核通过后方可使用。

综上所述,公司对子公司的管理能够实现对子公司的全面有效的控制。

(二)结合公司对子公司管理相关内部控制的规定,说明是否能及时排查并解决可能导致子公司失控的风险事项

公司设立内部审计部门,负责制定完善子公司各项内部控制制度,监督子公司规范日常经营管理,定期或不定期对子公司各项业务进行检查,督促子公司对存在缺陷的业务进行整改,有效防范子公司失控风险。

采购方面,公司制定了《采购业务管理制度》,从采购需求计划、供应商筛选及管理、合同协议的签订、原材料验收入库以及后续的货款支付等各方面,促进子公司合理采购,保障生产经营所需,规范采购行为,防范采购风险。

销售方面,公司制定了《销售业务管理制度》,从销售订单的签订、产品的发货、客户管理、货款的回收等多方面对子公司销售业务进行约束管理,有效控制相关业务的风险。

研发方面,公司制定《研究与开发管理制度》,加强研发项目的立项、实施、验收、成果转化以及核心技术保护等全过程的内部控制,有效防范子公司研发风险。

信息披露方面,公司制定了《重大信息内部报告制度》,明确子公司应及时向公司上报信息的披露范围、确定信息披露上报相关责任人以及未及时上报信息的责任追究。积极拓宽内部信息传递渠道、搭建线上线下相结合的有效沟通传递机制,促进信息传递渠道多元化,保障信息传递的时效性,同时加强对子公司相关人员的制度培训,提高相关责任人对信息披露重要性的认知,达到主动及时向公司传递信息的效果,从而进一步加强公司对子公司风险事项的管控能力。

用印管理方面,各子公司需按照《印章管理制度》申请用印,由公司法务部以及副总经理审核文件内容,并由负责保管各子公司印章的公司资金部人员负责对用印文件进行盖章。从该制度以及管控流程上能有效防止各子公司对外出具可能侵害上市公司利益的文件。

综上所述,公司能够及时排查并解决可能导致子公司失控的风险事项。

二、年审会计师核查程序及核查意见

(一)核查程序

年审会计师履行了如下核查程序:

1、访谈公司管理层,了解公司在子公司重大经营决策、人员派驻、资金客户技术等关键资源管控方面的安排;

2、获取公司相关内部控制的文件,了解公司对子公司管理的相关内部控制规定。

(二)核查结论

经核查,持续督导机构认为:

1、公司在子公司重大经营决策、人员、财务、客户和技术资源管控等方面均作了相应管理安排,能够对子公司实施有效管控;

2、公司在采购、销售、研发、信息披露及用印管理等方面均设置了与子公司管理相关的内部控制规定,能够监督子公司规范日常经营,能够及时排查并解决可能导致子公司失控的风险事项。

问题 8:关于关联交易

年报显示,报告期内公司向联营企业矽谷半导体关联采购 953.60 万元,向其关联销售 211.99 万元,而矽谷半导体 2022 年营业收入仅 1040.82 万元,亏损 799.86 万元,同时公司在 2023 年通过增资 250 万元的方式将矽谷半导体并表。请公司说明与矽谷半导体关联交易的具体内容、数量价格、交易原因及必要性、定价政策及依据、支付结算方式、回款情况,以及与非关联方采购销售对比说明关联交易的公允性。

一、公司回复

(一)公司向矽谷半导体关联采购情况

1、2022 年度主要采购情况如下

单位:万元

关联方	采购内容	采购数量	采购不含税金额	结算方式	付款情况
矽谷半导体	芯片固晶机 P8	4	55.93	预付 50%,尾款月结 30 天	56.88
	芯片固晶机 R8	2	38.94	预付 50%,尾款月结 30 天	30.80
	芯片固晶机 X12	10	276.11	预付 50%,尾款月结 30 天	258.58
	芯片固晶机 X8(注 1)	5	135.00	预付 50%,尾款月结 30 天;预付 30%,发货前支付 30%,货到 3 个月内付 30%,6 个月内付清尾款 10%;下单后 7 天内付 45%,出货前付 25%,到货后付 20%,验收合格付 10%	419.65
	芯片固晶机 X8P	6	169.91	预付 50%,尾款月结 30 天;预付 30%,发货前支付 30%,货到 3 个月内付 30%,6 个月内付清尾款 10%	153.60
	芯片固晶机 XP12	6	249.56	预付 50%,尾款月结 30 天	253.80
	技术服务费	1	23.28	对账后月结 30 天	24.67

注 1:2022 年 1 月,公司与矽谷半导体签订《供货合同》,购买 20 台芯片固晶机 X8、10 台芯片固晶机 X12,合同总价 986.20 万元(含税),公司按合同约定条款支付货款;2022 年 8 月及 10 月,因终端客户试用需求变化,公司退回已交付的 7 台芯片固晶机 X8,经协商,已支付的 7 台芯片固晶机 X8 货款作为新增订单的预付款。

2、交易原因及必要性

公司自 2016 年开始布局半导体封测设备业务方向,目前公司半导体封测设备收入来源为主要为测试分选一体机,为进一步加强对其他半导体设备的了解和认识,积累其他半导体设备客户资源,公司采购了矽谷半导体固晶机。公司采购矽谷半导体的固晶机符合公司拓展半导体设备业务方向,了解半导体固晶机技术及市场的需求,能够为公司进一步发展半导体固晶机业务奠定基础。

3、定价政策及依据

遵循自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则,在参考市场价格的基础上,通过公允、合理协商方式确定关联交易价格。

4、关联交易的公